



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071221003

2008 年 1 月 8 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 

DIP (20N/24NT/24NTG), PQCC-J (68FN) パッケージ一部製品 組立サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

品

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)		☐ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	DIP (20N/24NT/24NTG), PQCC-J (68FN) パッケージ一部製品 組立サイト追加 現行 : CARSEM社/CARSEM社-S (マレーシア) 変更後 : CARSEM社/CARSEM社-S (マレーシア) 及びMMT社 (旧AlphaTec: タイランド)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2008 年 4 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ30日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) DIP (20N/24NT/24NTG), PQCC-J (68FN) パッケージ一部製品の組立サイトについて、現行 CARSEM社/CARSEM社-S(マレーシア)サイトにて製造しておりますが、これに加えMMT社(旧AlphaTec: タイランド)での製造を追加し認定する予定です。この変更に伴い、下記の様に若干の部材の変更がありますが、弊社他製造サイトにて量産に適用されているものです。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。

パッケージ	項目	現行	追加変更内容
PDIP (20N)	製造サイト	CARSEM-S	MMT
	マウントコンパウンド	Able 8290	Able 2200
	モールドコンパウンド	G600C	G600V
PQCC-J (68FN)	製造サイト	CARSEM-S	MMT
	マウントコンパウンド	Able 8290	EN-4085S2K3
	モールドコンパウンド	G700FG	G700HC
PDIP (24NT)	製造サイト	CARSEM	MMT
	マウントコンパウンド	Able 84-1LMISNB Able 8290	Able 2200
	モールドコンパウンド	EME6300H G600C	G600V
PDIP (24NTG)	製造サイト	CARSEM	MMT
	マウントコンパウンド	Able 8290	Able 2200
	モールドコンパウンド	G600C	G600V

理由: 供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
PDIP (20N)				
UC2638N	UC2876NG4	UC3875N	UCC28501NG4	UCC38502N
UC2638NG4	UC2879N	UC3875NG4	UCC28502N	UCC38502NG4
UC2855AN	UC2879NG4	UC3876N	UCC28502NG4	UCC38503N
UC2855ANG4	UC2909N	UC3876NG4	UCC28503N	UCC38503NG4
UC2855BN	UC2909NG4	UC3879N	UCC28503NG4	UCC3895N
UC2855BNG4	UC3638N	UC3879NG4	UCC2895N	UCC3895NG4
UC2875N	UC3638NG4	UC3909N	UCC2895NG4	UCC39422N
UC2875N/81290	UC3855AN	UC3909NG4	UCC38500N	UCC39422NG4
UC2875N/81290G4	UC3855ANG4	UCC28500N	UCC38500NG4	UCC3956N
UC2875NG4	UC3855BN	UCC28500NG4	UCC38501N	-
UC2876N	UC3855BNG4	UCC28501N	UCC38501NG4	-
PDIP (24NT)				
ADS7800KP	ADS7800KP4	DAC7801LP	-	-
PDIP (24NTG)				
ADS1211P	ADS1211PG4	ADS1213P	ADS1213PG4	DAC7802LP
PQCC-J (68FN)				
VECANA01	VECANA01G3	-	-	-

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2007 年 8 月	終了	2008 年 2 月
PDIP 20N				
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	UCx87xN	Die Size (mils):	170 x 118	
Wafer fab Site:	SHE	Technology:	Bi-POLAR	
Fab Processe:	BIP-DLM	Metal 1-2:	AL Cu	
Assembly Site:	MMT	Package Code/ Pin:	N / 20	
Mount compound:	2200	Mold Compound:	G600V	
Lead Finishe:	NI/PD/AU			
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Lot x Sample size	Note
Biased HAST:	130C/85%RH, 96 hrs		3 x 77	-
Temp Cycle:	-65/150C, 1000 Cyc)		3 x 77	-
Manufacturability:	per mfg. Site specification		3 x 77	-

PDIP 24NT

信頼性試験 - 試料構成詳細

Device:	ADS7800KP	Die rev/ Size(mils):	C / 136 x 184	
Wafer fab Site:	Dalsa	Technology/ Process:	CMOS / 490N	
Metal 1:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	Metal 2:	9kA AlCu(.5%)	
Resistor technology:	SiCr	Passivation:	5kA(SiO2)/9kA(SiON)	
Assembly Site:	MMT	Package Code/ Pin:	NT / 24	
Mount compound:	Able 2200D	Mold Compound:	G600V	
Wire Bond Method:	1.3 Au TS	Lead Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu	
Flammability Rating:	UL94-V0			
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample size	Note
Steady-state Life Test	125C, 1000hrs		116	(1)
Biased HAST	130C/85%RH, 96hrs		77	(1)
Autoclave 121C	121C, 96hrs		77	(2)
T/C -65C/150C	-65C/150C, 1000cys		77	(2)
Solder Heat	260C, 10 seconds		22	(2)
Solderability	Steam age, 8hrs		22	(2)
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units		22	-
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units		22	(2)
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units		15	-
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5	(2)
Flammability	Method A - UL94-0		5	(2)
	Method B - IEC 695-2-2		5	(2)
	Method C - UL 1694		5	(2)
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76	-
Die Shear	-		10	-
Manufacturability	per mfg. Site specification		-	-
Salt Atmosphere	24hrs		22	-
X-ray	top side only		5	-
High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs		77	(3)
Note:				
(1) : Qualification data for CarsemM G600 Enterprise Qual will be utilized.				
(2) : Qualification data for 20N/24NT MMT Green Qual will be utilized.				
(3) : Qualification data for MMT NT/NTD 28Ld G600 Qual will be utilized.				

PDIP 24NTG			
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Device:	DAC7802LP	Die rev/ Size(mils):	C / 140 x 143
Wafer fab Site:	OKI	Technology/ Process:	CMOS / Oki 3um
Metal 1:	AlSi (1.5%)	Metal 2:	AlSi (1.%)
Resistor technology:	NiCr	Passivation:	5kASiO2/8kASiON
Assembly Site:	MMT	Package Code/ Pin:	NTG / 24
Mount compound:	Able 2200D	Mold Compound:	G600V
Wire Bond Method:	1.3 Au TS	Lead Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu
Flammability Rating:	UL94-V0		
信頼性試験計画			
Reliability Test	Condition / Duration	Lot x Sample size	Note
Steady-state Life Test	125C, 1000hrs	3 x 116	(1)
Biased HAST	130C/85%RH, 96hrs	3 x 77	(1)
Autoclave 121C	121C, 96hrs	2 x 77	
T/C -65C/150C	-65C/150C, 1000cys	2 x 77	
Solder Heat	260C, 10 seconds	2 x 22	
Solderability	Steam age, 8hrs	2 x 22	
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	2 x 22	
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	2 x 22	
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	2 x 15	
Physical Dimensions	per mechanical drawing	2 x 5	
Flammability	Method A - UL94-0	2 x 5	(2)
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	2 x 5	(2)
Flammability	Method C - UL 1694	2 x 5	(2)
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	2 x 76	
Die Shear	-	2 x 10	
Manufacturability	per mfg. Site specification	-	
Salt Atmosphere	24hrs	2 x 22	
X-ray	top side only	2 x 5	
High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs	2 x 77	(2)
DPA Destructive Physical Analysis	-	2 x 5	
Note:			
(1) : Qualification data for CarsemM G600 Enterprise Qual will be utilized.			
(2) : Qualification data for 20N/24NT MMT Green Qual will be utilized.			
(3) : Qualification data for MMT NT/NTD 28Ld G600 Qual will be utilized.			

PQCC-J : 68FN			
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Device:	VECANA01	Die rev/ Size(mils):	U / 238 x 279
Wafer fab Site:	Dalsa	Technology/ Process:	CMOS / P490
Metal 1:	AlSi 1.5%	Metal 2:	AlSi 1.0%
Resistor technology:	SiCr	Passivation:	5kASiO2/8kASiON
Die Overcoat:	PI-2562	-	-
Assembly Site:	MMT	Package Code/ Pin:	FN / 68
Mount compound:	EN-4085S2K	Mold Compound:	G700HC
Wire Bond Method:	1.3 Au TS	Lead Composition/ Finish:	Cu / Matte Tin
Flammability Rating:	UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	Pending L3/260C
信頼性試験計画			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample size	Note
** Steady-state Life Test	125C, 1000hrs	116	(1)
** Biased HAST	130C/85%RH, 96hrs	77	(1)
** Autoclave 121C	121C, 96hrs	77	(1)
** T/C -65C/150C	-65C/150C, 1000cys	77	(1)
Solder Heat	260C, 10 seconds	22	
Solderability	Steam age, 8hrs	22	
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22	
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22	
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	15	
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5	
Flammability	Method A - UL94-0	5	
	Method B - IEC 695-2-2	5	
	Method C - UL 1694	5	
Electrical Char.	Full Temperature range	30	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	
Die Shear	-	10	
Manufacturability	per mfg. Site specification	-	
Salt Atmosphere	24hrs	22	
X-ray	top side only	25	
** High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs	77	(1)
Moisture Sensitivity	-	24	(2)
Moisture Sensitivity Level 4	-	24	(3)
DPA Destructive Physical Analysis	Post Temp cycle Sample to include all lots	3	
Note:			
** Test requires Moisture Preconditioning.			
(1) Delta MSL 3 & 4 Must be determined before all other electrical Reliability test start			
(2) (level 3 @ 260C peak +0/-5C) MSL w/ deltas for Pre to post reflow			
(3) (level 4 @ 260C peak +0/-5C) with deltas(pre to post reflow)			

製品表示

製造サイト追加に伴い、製品表示の製造サイトを示すコード("S"の部分)が、"V"(CARSEM 社),"W"(CARSEM 社-S)に、"G"(MMT:タイランド)が追加となる予定です。

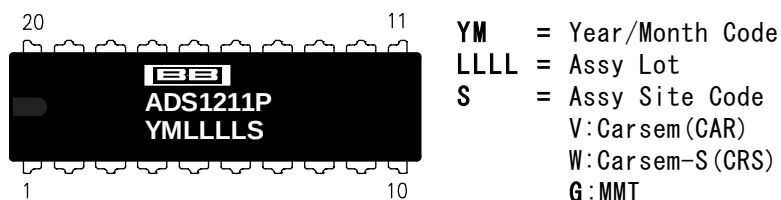


図 1 製品表示の例